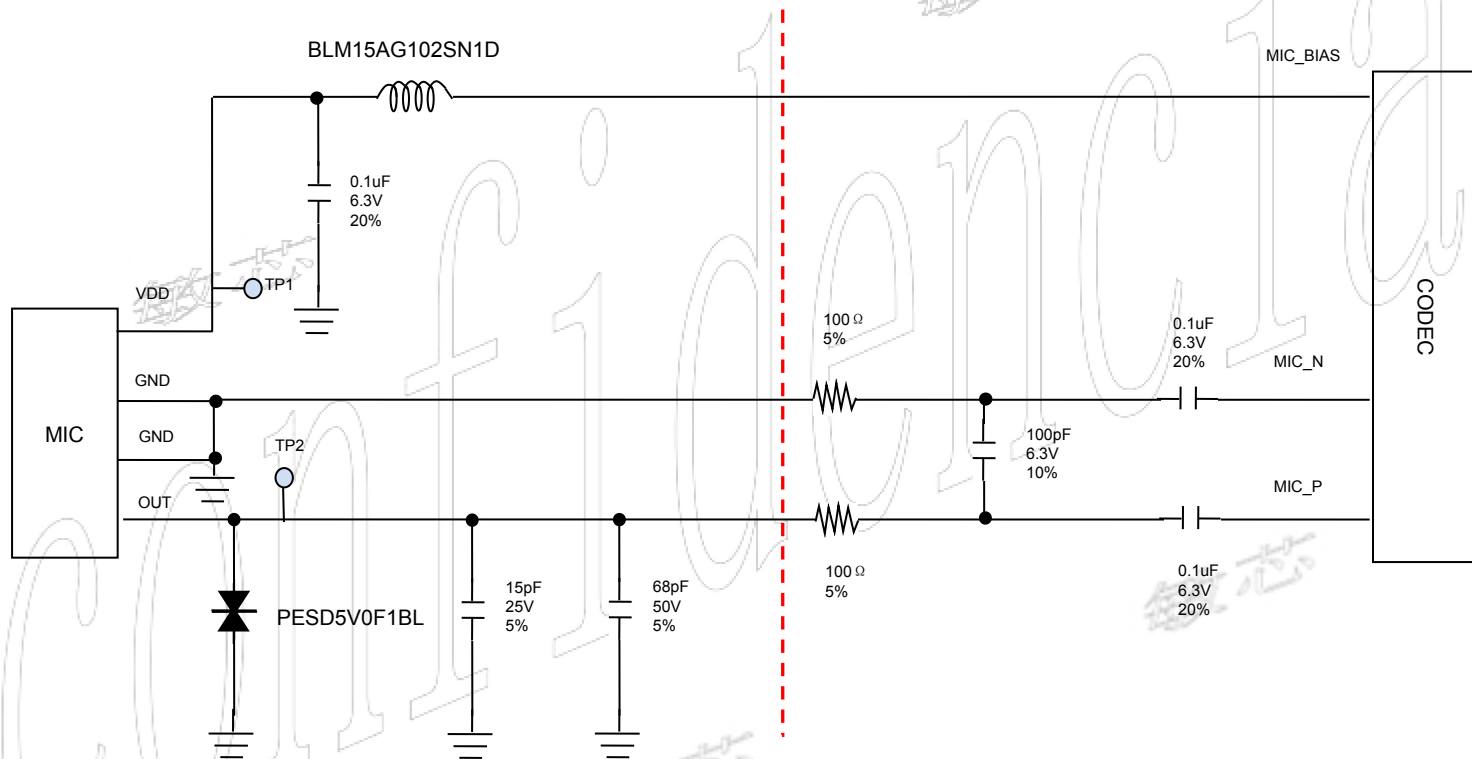


原理图绘制及PCBlayout工程师须知:

1、典型手机应用参考电路:



※红色虚线右侧部分应layout在主板上或靠近codec，红色虚线左侧部分应layout在小板或MIC附近。

原理图绘制及PCB layout工程师须知:

2、test point的设置

PCB layout时，请务必参照原理图将MIC的VDD和OUT做出测试点TP1和TP2，以便于生产过程中的PCBA测试和后期的MIC失效/不吹咪分析。（重要!!!）

3、GSM信号可以通过耦合和传导的方式干扰到音频。用户可以通过在音频通路上增加33PF和10PF电容来滤除耦合干扰。33PF的电容主要滤除GSM900频段的干扰，10PF电容主要滤除DCS1800频段的干扰。TDD的耦合干扰和用户的PCB设计有很大关系，有些情况下900频段的TDD比较严重，而有些情况下1800频段的TDD干扰比较严重。因此用户可以根据实际测试结果选贴需要的滤波电容，甚至有时不需要贴滤波电容。

GSM的天线是TDD主要的耦合干扰源，因此用户在PCB布局和走线时要注意将音频走线远离RF天线，音频输出MICP和MICN要按照差分信号规则走线。TDD和GND也有很大关系，如果GND处理不好，很多高频的干扰信号会通过旁路电容等器件干扰到MIC，所以用户在PCB设计阶段要保证MIC的GND PIN下地良好很重要。